## ドロップレットフィルタ兼用陽極を用いた 直流フィルタードアーク蒸着による TiN 膜形成

TiN Film Formed by DC-Filtered Arc Deposition with Anode Acting as Droplet Filter 豊橋技科大<sup>1</sup>、オーエスジーコーティングサービス(株)<sup>2</sup>

<sup>o</sup>鬼頭 純平<sup>1</sup>, 橋本 侑樹<sup>1</sup>, 税木 善則<sup>1</sup>, 坂東 隆宏<sup>1</sup>, 針谷 達<sup>1</sup>, 滝川 浩史<sup>1</sup>, 儀間 弘樹<sup>2</sup> Toyohashi Univ. Technol.<sup>1</sup>, OSG Coating Service Co., Ltd.<sup>2</sup>

<sup>o</sup>Jumpei Kito<sup>1</sup>, Yuki Hashimoto<sup>1</sup>, Yoshinori Saiki<sup>1</sup>, Takahiro Bando<sup>1</sup>, Toru Harigai<sup>1</sup>,

Hirofumi Takikawa<sup>1</sup>, Hiroki Gima<sup>2</sup>

E-mail: kito.jumpei.jq@tut.jp

1. はじめに

切削加工具の保護膜として,窒化チタン膜 (TiN 膜)が用いられている。工業的製法とし て,真空アーク蒸着(vacuum arc deposition: VAD) 法が広く利用されている。同法では,イオン化 率が高いプラズマが得られるため,緻密性に優 れ,高い密着性を示す薄膜が成膜できるからで ある<sup>1)</sup>。しかしながら,蒸発源である陰極から ドロップレットと呼ばれる微粒子が放出され る。このドロップレットが膜表面に付着すると, 平滑性などの膜質を低下させる<sup>2)</sup>。ドロップレ ットを低減させる方法として,VAD 法を高機 能化したフィルタードアーク蒸着(filtered arc deposition: FAD)法がある。

本研究では、「く」の字形状を呈したコイル を陽極として用い、直流アーク電流自身によっ てフィルタ磁界を発生させる屈曲状フィルタ ードアーク蒸着システム (winding-type filtered arc deposition: W-FAD)を開発した。同システム および、比較のため、円筒状陽極を用いた直線 状フィルタードアーク蒸着システム (Lineartype filtered arc deposition: L-FAD)を用い、TiN 膜を作製した。

## 2. 実験方法

成膜条件は次の通りとした。陰極:Ti, プロ セスガス:N<sub>2</sub>, 流量:30 sccm, プロセス圧力: 0.3 Pa, アーク電流:110 A, 陰極-陽極間外部の 真空ダクト外部に設けた電磁コイルの電流:2 A。成膜時間は, L-FAD および W-FAD で, そ れぞれ,5分および 60分とした。基板には工 具母材に使用される超硬(WC)を用いた。作 製した膜に関し, 次のように分析した。膜厚: カロテスト,表面形状:SEM,表面粗さ:レー ザー顕微鏡。

3. 実験結果と考察

両システムの陽極出口のプラズマの様子を Fig.1に示す。L-FADでは生成されたプラズマ ビームは陰極から基板に向かって直進してい ることがわかる。一方,W-FADではコイルア ノードに沿って屈曲し,基板まで輸送されてい ることがわかる。同図から,直流アーク放電に おいても,コイル状陽極を用いてプラズマを磁 気的に輸送できることがわかった。

両システムで作製した TiN 膜の膜厚は, L-FAD および W-FAD でそれぞれ 1.8 µm および



Fig. 1 Photographs of plasma beams at anode exit of filtered arc; (a) L-FAD and (b) W-FAD



Fig. 2 SEM micrographs of TiN films on WC substrate; (a) L-FAD and (b) W-FAD

1.7 μm であった。従って,成膜速度は L-FAD および W-FAD で,それぞれ,360 nm/min およ び 28 nm/min であり,W-FAD の成膜速度は L-FAD のそれの約 1/10 であった。これは,L-FAD では,真空アークで発生したイオンと同時に原 子も成膜に寄与しているのに対し,W-FAD で はイオンのみが成膜に寄与していることが主 因である。

L-FAD および W-FAD で成膜した TiN 膜表面 の SEM 写真を, それぞれ, Fig. 2(a)および(b)に 示す。同様な写真複数毎を用いて, 100 µm×100 µm の範囲におけるドロップレット数を数えた ところ, L-FAD および W-FAD で, それぞれ, 約40 個および約4 個であった。このことから, L-FAD と比べ W-FAD は, ドロップレットの生 成膜への付着を大幅に防止できることがわか った。

以上から,W-FAD は成膜速度を犠牲にする ものの,ドロップレットの付着が極めて少ない 膜を形成できることがわかった。

謝辞 本研究の一部は,科学研究費補助金(課題番号: 22H01470)の助成を受けて行われた。本研究では,豊 橋技術科学大学教育研究基盤センターの共用機器を利 用した。

参考文献

- 1) 岡本康治, 上篠栄治: 真空, 30, 10, 786 (1987)
- 2) A. Bendavid, et al., Thin Solid Films, 360, 241 (2000).